

UNA GRANDE SFIDA PER L'AUTOMAZIONE



Milano ancora una volta, per 4 giorni, dal 4 al 7 maggio prossimi sarà la "capitale dell'innovazione industriale". Il nuovo progetto di Bias è stato infatti costruito su misura per offrire al mercato uno strumento che davvero gli consenta di ripartire, favorendo l'incontro fra domanda e offerta e la formazione tecnico-professionale



Questo il "diktat" dell'edizione 2010 di BIAS, che si terrà in fieraMilano dal 4 al 7 maggio prossimi e che si presenta con un progetto interamente rinnovato. Un cambiamento importante generato dal confronto con le aziende e i visitatori ma anche con gli autorevoli esperti di settore che hanno accettato di far parte del Comitato Tecnico Scientifico della manifestazione: AIS, Anipla, GISI, FAST, ANIE-Assoautomazione, ANIE-Componenti Elettronici, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Bologna, oltre a rappresentanti di importanti gruppi editoriali specializzati.

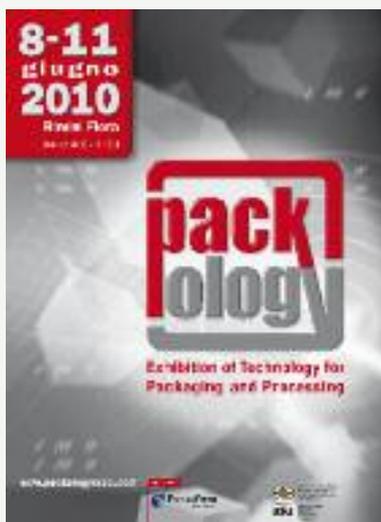
Pur mantenendo una sola identità e la forza di un marchio dalla grande tradizione, BIAS, volendo dare una risposta concreta alla richiesta di strutturare i contenuti in modo verticale e specialistico, si ripropone diviso in 5 macroaree, Automation, Instrumentation, Electronics Production, Microelectronics & Components, IT for Manufacturing, ciascuna dedicata a un singolo settore, rendendo più semplice l'individuazione dei percorsi di visita per l'operatore alla ricerca di soluzioni specifiche. A questa razionalizzazione espositiva, si affianca una forte attenzione alle tematiche più innovative, cui sono dedicate le "isole tematiche". Bias Lab rappresenta l'innovazione

"rivoluzionaria", presentata da importanti laboratori universitari, divisioni R&D di grandi aziende e spin-off che operano nei distretti di ricerca. Una sintesi dell'eccellenza tecnologica made in Italy, con importanti esempi di "innovazione spinta": dalla robotica avanzata alle nanotecnologie, dai nuovi materiali alle più innovative tecnologie software.

Uno sguardo sull'innovazione di domani e un'opportunità di fornire formazione di alto livello tecnico-scientifico attraverso le presentazioni e i micro-seminari a ciclo continuo che la animano. T&M, il cuore dinamico del settore "Instrumentation", è l'isola dedicata al Testing & Measurement, attraverso esempi di strumentazione virtuale e tradizionale da laboratorio, permette di dimostrare "dal vivo" il funzionamento di un laboratorio di misura avanzato, dedicato alle applicazioni in alta frequenza (wireless, ecc.) e di un laboratorio di misura in ambito industriale, con strumenti virtuali. Risparmio ed efficienza energetica: realizzata in collaborazione con ANIE-Assoautomazione, l'isola riunisce componenti, tecniche, sistemi per l'efficienza energetica negli ambienti di produzione, con particolare riferimento alle soluzioni complete (azionamenti, motori, sottosistemi elettronici).

Presenta inoltre alcune soluzioni microelettroniche per la realizzazione di moduli e sottosistemi avanzati ad altissima efficienza energetica, applicabili in ambiente industriale. Wireless Solutions for Industry offre un ampio panorama di soluzioni wireless per l'asset management, la tracciabilità dei prodotti, il controllo del flusso della produzione e la logistica (interna ed esterna). Una risposta innovativa ai problemi di "visibilità" e di "tracciabilità" dei flussi fisici dei prodotti lungo la filiera, che possono essere fonte di diseconomie e di inefficienza e possono trovare nelle tecnologie wireless una risposta. Anche nel 2010 BIAS farà parte della TEW, la Technology Exhibitions Week, insieme a Fluidtrans Compomac (Biennale Internazionale di Trasmissioni di Potenza Fluida e Meccatronica) e Mechanical Power Transmission & Motion Control (Biennale Internazionale di Trasmissioni Meccaniche, Motion Control e Meccatronica): una contemporaneità che consentirà di soddisfare le molteplici esigenze di costruttori e progettisti alla ricerca di prodotti, componenti e soluzioni innovativi e originali rivolti ai diversi ambiti industriali di applicazione, consacrando Milano ancora una volta, per 4 giorni, "capitale dell'innovazione industriale".

ECCELLENZA & INTERNAZIONALITÀ



L'eccellenza e l'internazionalità saranno i tratti caratteristici di Packology, la fiera del packaging dei costruttori italiani, che nasce dalla partnership fra l'Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche (UCIMA) e Rimini Fiera Spa. La prima edizione si svolgerà da martedì 8 a venerdì 11 giugno 2010 e avrà una cadenza triennale. La manifestazione è stata pensata come un

importante contenitore professionale che esalti le innovazioni delle aziende leader a livello internazionale nel campo del processing e del packaging, nei comparti food, beverage, chimico, cosmetico, farmaceutico, healthcare e beni di consumo. Lungo otto padiglioni del quartiere fieristico, per un'area complessiva di 60.000 m², saranno in mostra macchine per il confezionamento, macchine di processo, materiali per imballaggi, tecnologie per l'etichettatura, la codifica e la marcatura, accessori e componenti, tecnologie legate alla logistica, stampa ed editoria. A Packology, gli espositori potranno incontrare one-to-one buyer provenienti in particolare dai Paesi del Mediterraneo, dell'Est Europa, dell'Area Balcanica e del Medio Oriente. La fiera intende quindi affermarsi come l'evento espositivo dei Costruttori Italiani di Macchine Automatiche per il confezionamento e l'imballaggio.



La fiera di Rimini

**6-petals
rupture disc**
direct + reverse
scored

Confirmation on quality assurance
according to nuclear standard KTA 1401

On behalf of the German nuclear power plant operators
E.ON Energy Research Group as a partner of the VGB PowerTech e. V. working
group "Assessment of Contractors" confirms

Donadon SDD S.R.L.

**ASK US
WHY?**

Tel. +39 0290111001 Fax +39 0290112210
donadonsdd@donadonsdd.com

100% Italian

www.donadonsdd.com